## <sup>05;11</sup> Увеличение плотности нанокластеров $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> на поверхности Si(111) с помощью формирования реконструкции Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ -B

© М.В. Иванченко, Е.А. Борисенко, В.Г. Котляр, О.А. Утас, В.В. Устинов, В.Г. Лифшиц

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток E-mail: maxim@iacp.dvo.ru Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург

## Поступило в Редакцию 29 ноября 2005 г.

С помощью метода сканирующей туннельной микроскопии исследовано формирование нанокластеров дисилицида железа  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> в результате твердофазной эпитаксии при температурах отжига  $500-700^{\circ}$ С и покрытиях железа 0.05-0.5 моноатомного слоя на модифицированной бором поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^{\circ}$ -В. Сопоставление с результатами для чистой поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^{\circ}$ -В сопоставление с результатеров  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> на Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^{\circ}$ -В значительно превышает их плотность на поверхности Si(111)7 × 7. При этом плотность точечных дефектов и структур, обладающих металлическим типом проводимости, на поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^{\circ}$ -В на несколько порядков ниже, чем на поверхности Si(111)7 × 7 при аналогичных покрытиях Fe и температурах отжига.

PACS: 81.07.-b

Благодаря активному использованию оптических соединений в последние годы значительно возрос интерес к прямозонным полупроводниковым силицидам. Длина волны излучения  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> идеально соответствует максимуму пропускания оптоволоконных структур, что необходимо для создания эффективных оптических передатчиков [1–3]. Для уменьшения размеров светоизлучающих приборов исследуются структуры на основе наночастиц  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> [4–6]. Однако из-за снижения эффективности излучения при повышении температуры лишь некоторые из многочисленных работ сообщают о фотолюминесценции частиц  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>, внедренных в p-n-переход, при комнатной температуре [5].

58

Среди причин снижения эффективности одной из основных является безызлучательная рекомбинация носителей на дефектах [7].

Хотя массивный силицид  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> стабилен, сплошные тонкие пленки этого силицида сложно вырастить на поверхности Si(111), так как из-за несоответствия решеток имеет место островковый рост. При этом известно, что, как правило, происходит формирование нескольких видов островков. Кроме островков со структурой β-FeSi<sub>2</sub> (такие островки состоят из трех доменов, разделенных углублениями вдоль направлений [112]), образуются островки со структурой дисилицида у-FeSi<sub>2</sub>, обладающего металлическими свойствами [2] (такие островки имеют реконструкцию  $2 \times 2$  на поверхности островка) [8,9]. Присутствующие частицы у-FeSi2 могут служить центрами безызлучательной рекомбинации, а также дефектами, увеличивающими вероятность пробоя. Так как атомная структура поверхности оказывает значительное влияние на рост пленок, мы исследовали силицидообразование на модифицированной бором поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3R30^{\circ}}$ -В с целью улучшения однородности структуры островков, а также повышения их плотности.

Эксперименты проводили в сканирующем туннельном микроскопе (СТМ) фирмы "Omicron" с базовым давлением 1.2 · 10<sup>-10</sup> Torr. В качестве подложек использовали пластины кремния *n*-типа с удельным сопротивлением  $0.03 \,\Omega \cdot \text{сm}$  и размером  $12 \times 2 \times 0.5 \,\text{mm}$ . Атомарно-чистую поверхность Si(111)7 × 7 получили in sity кратковременным отжигом при 1280°С после того, как образец был прогрет при 600°С в течение нескольких часов. Поверхность Si(111) со структурой  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^{\circ}$ -В получали разложением оксида бора B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, который осаждали из эффузионной ячейки из нитрида бора на поверхность Si(111)7 × 7 при температуре образца 800°С [10]. Пленки Fe осаждали из танталовой эффузионной ячейки. Для формирования нанокластеров использовали метод твердофазной эпитаксии (ТФЭ), а именно напыленные при комнатной температуре пленки Fe отжигали при заданной температуре в диапазоне 500-700°С в течение 5 min пропусканием тока через образец. Для исследования поверхности методом СТМ использовались вольфрамовые иглы, получаемые электрохимическим травлением и очищенные отжигом в вакууме. СТМ изображения получали в режиме постоянного тока после охлаждения образца до комнатной температуры.

60



**Рис. 1.** a — СТМ-изображение (200 × 140 nm, -2.0 V, 0.19 nA) заполненных состояний поверхности Si(111)7 × 7 после осаждения 0.5 MC Fe с последующим отжигом при 700°С. Область неупорядоченной структуры обозначена буквами D.A. b — СТМ-изображение (30 × 30 nm, -1.9 V, 0.19 nA) заполненных состояний поверхности Si(111)7 × 7 после осаждения 0.5 MC Fe с последующим отжигом при 700°С. В центре виден островок  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>. Углубления, разделяющие островок на домены, обозначены стрелками. c — СТМ-изображение (30 × 30 nm, -1.9 V, 0.17 nA) заполненных состояний поверхности Si(111)7 × 7 после осаждения 0.2 MC Fe с последующим отжигом при 600°С. В центре виден островок  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub>. d — СТМ-изображение (30 × 30 nm, 2.0 V, 0.37 nA) незаполненных состояний поверхности Si(111)7 × 7 после осаждения 0.2 MC Fe с последующим отжигом при 600°С. В центре виден островок  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> с частицей  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub> в центре.

Результаты наших контрольных экспериментов по ТФЭ на поверхности Si(111)7 × 7 в целом согласуются с известными литературными данными. Общие тенденции формирования островков на поверхности Si(111)7 × 7 в диапазоне покрытий 0.05-0.5 моноатомного слоя (MC) Fe и температур 550-700°C следующие. Формирование островков начинается при температуре  $550^{\circ}$ C (рис. 1, *a*-*d*). Одновременно с ростом островков на поверхности формируются области с неупорядоченной структурой (рис. 1, а, b). Эти области начинают расти от атомных ступеней и доменных границ исходной структуры  $Si(111)7 \times 7$ , и их площадь увеличивается с ростом покрытия Fe. При температуре 700°С и покрытии Fe до 0.2 МС на поверхности формируются только островки β-FeSi<sub>2</sub>. При меньших температурах отжига и при больших покрытиях Fe формируются также островки у-FeSi2, которые составляют примерно четвертую часть от общего числа островков. Встречались также островки  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>, в центре которых формировались частицы  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub> (рис. 1, c). При изменении температуры отжига и покрытия Fe суммарная плотность всех островков остается практически постоянной.

При ТФЭ на поверхости Si(111) со структурой  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ -В области неупорядоченной фазы не образуются, а происходит только рост островков (рис. 2, *a*). Плотность и размер островков сильно зависят от температуры отжига. В диапазоне 500–700°С температурная зависимость плотности островков *N* описывается соотношением Аррениуса:

$$N = N_0 \exp\left(\frac{E_{eff}}{k_{\rm B}T}\right),$$

где T — температура отжига,  $k_{\rm B}$  — постоянная Больцмана, а эффективная энергия активации  $E_{eff}$  равна  $(0.87 \pm 0.03)$  eV. В результате при изменении температуры на 200°C плотность островков меняется примерно на порядок величины. С ростом покрытия Fe плотность островков возрастает практически линейно, как видно из сравнения данных для начальных покрытий 0.2 и 0.5 MC (показаны черными и белыми квадратиками соответственно на графике на рис. 2, *b*). Это сильно отличается от результатов для ТФЭ на поверхности Si(111)7 × 7, где плотность островков практически не зависит от температуры и покрытия (см. данные, показанные черными и белыми кружками на графике на рис. 2, *b*). Отметим также то, что плотность островков на

62



**Рис. 2.**  $a - \text{СТМ-изображение} (200 × 140 nm, 1.8 V, 0.17 nA) незаполненных состояний поверхности Si(111)<math>\sqrt{3} × \sqrt{3}R30^\circ - \text{В}$  после осаждения 0.5 MC Fe с последующим отжигом при 700°C. Вставка: СТМ-изображение (30 × 30 nm, -1.9 V, 0.19 nA) заполненных состояний поверхности Si(111) $\sqrt{3} × \sqrt{3}R30^\circ - \text{В}$  после осаждения 0.2 MC Fe с последующим отжигом при 700°C. В центре виден островок  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>. Углубления, разделяющие островок на домены, обозначены стрелками. b -график Аррениуса, показывающий зависимость плотности нанокластеров N на поверхности в зависимости от температуры T твердофазной эпитаксии: 0.5 MC и 0.2 MC Fe на реконструкции  $B\sqrt{3}$  (точки типов [a] и [b] соответственно); 0.5 MC и 0.2 MC Fe на Si(111)7 × 7 (точки типов [c] и [d] соответственно).

поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ –В всегда значительно выше, чем на поверхности Si(111)7 × 7.

Анализ структуры островков показал, что во всем исследованном диапазоне температур (500–700°С) и покрытий Fe (0.05–0.5 MC) все островки на поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ –В имеют структуру  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>, а островки  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub> с характерной структурой 2 × 2 на поверхности не образуются. Последнее может быть связано с тем, что островки  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> переходят в островки  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub> при достижении критического размера, а при росте на поверхности Si(111) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ –В плотность



Рис. 2 (продолжение).

островков настолько высока, что все островки имеют размер меньше критического.

Таким образом, можно сделать вывод, что присутствие структуры  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}R30^\circ$ -В на поверхности Si(111) приводит к значительному увеличению плотности островков  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub> при отсутствии областей неупорядоченной структуры и островков  $\gamma$ -FeSi<sub>2</sub> с металлическими свойствами, т.е. количество потенциальных излучающих центров возрастает при многократном снижении числа дефектов по сравнению с тем, что можно получить методом ТФЭ на поверхности Si(111)7 × 7.

Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ (№ 05-02-17823), НШ (№ 1369.2003.2), а также президиумов ДВО РАН и УрО РАН (№ 04-2-1-00-014).

Мы благодарим профессоров А.А. Саранина, А.В. Зотова и В.В. Коробцова за помощь в обсуждении результатов экспериментов.

## Список литературы

64

- [1] Bost M.C., Mahan J.E. // J. Vac. Sci. Technol. B. 1986. V. 4. P. 1336.
- [2] Christensen N.E. // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. N 11. P. 7148-7153.
- Bellani V., Guizzetti G., Marabelli F. et al. // Solid State Commun. 1995.
  V. 96 (10). P. 751–756.
- [4] Suemasu T., Fujii T., Takakura K., Hasegawa F. // Thin Solid Films. 2001.
  V. 381. P. 209–213.
- [5] Suemasu T., Negishi Y., Takakura K. et al. // Japan J. Appl. Phys. 2000. V. 39. Part 2. N 10B. P. L1013–L1015.
- [6] Lourenco M.A., Milosavljevic M., Gwilliam R.M. et al. // Thin Solid Films. 2004.
  V. 461. P. 219–222.
- [7] Lourenco M.A., Butler T.M., Kewell A.K. et al. // Japan J. Appl. Phys. 2001.
  V. 40(1). 6A. P. 4041–4044.
- [8] Manassen Y, Reaple H., Shneck R. et al. // Phys. Rev. B. 2003. V. 68. P. 075412-1–075412-11.
- [9] Krause M., Blobner F., Hammer L. et al. // Phys. Rev. B. 2003. V. 68, P. 125306-1–125306-10.
- [10] Nogami J., Yoshikawa S., Glueckstein J.S. et al. // Scanning Microscopy. 1994.
  V. 8. N 4. P. 835–840.